

## 組込みシステム開発技術展 ESEC2017 出展のご案内

お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社は、来る2017年5月10日(水)から12日(金)の3日間、東京ビックサイト西1ホールで開催される組込みシステム開発技術展 ESEC2017 に出展いたします。

様々な開発段階において、お客様の製品開発に貢献してまいりたいと考えており、以下の弊社技術を紹介させていただきます。

招待券を同封いたしますので、この機会にぜひともご来場下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社  
営業技術統括グループ

### 出展アイテム概要 (出展アイテムは変更される場合があります)

#### ◆ GPGPUプラットフォームソリューション

TegraX1とコンパチブルのTegraK1リファレンスボードによるデモを通して、NVIDIA社との連携による、お客様ニーズに沿ったGPGPUシステムのハードウェア/ソフトウェア開発サポートをご提案いたします

#### ◆ ボディエリアネットワーク技術

欧州電気通信標準化機構(ETSI)推進の無線通信規格SmartBANに対応。  
その特徴である複数センサの時間同期デモを通して、ソフトウェア開発のサポートをご提案いたします

#### ◆ FPGAリコンフィグレーション・プラットフォーム

最新ボードでのFPGAリコンフィグレーションデモを通して、リコンフィグレーション・プラットフォームの製品利用をご提案いたします。リコンフィグレーション・プラットフォームはIntel、XILINXのFPGAに対応可能

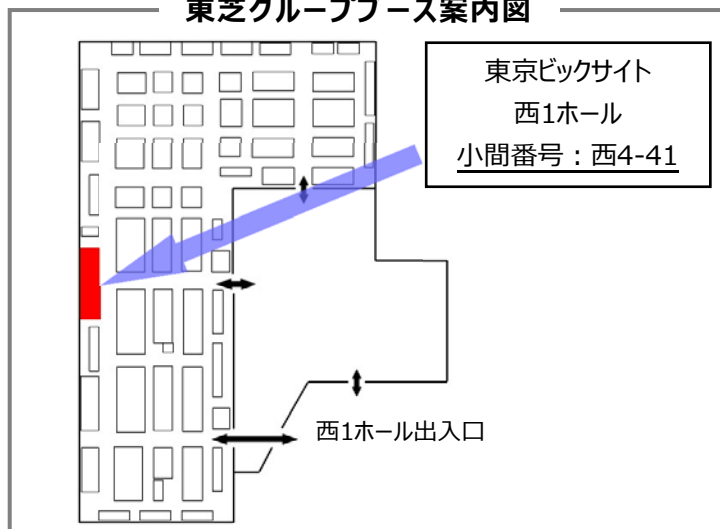
#### ◆ ミリ波伝送システム

ミリ波(60GHz帯)を使用した近距離高速通信のデモを通して、ミリ波の特徴である耐環境性、アンテナの小型化などを活かした、製品開発サポートをご提案いたします

#### ◆ ストレージインタフェース開発ソリューション

ストレージ(SSD、HDDなど)搭載機器の開発でのインターフェース問題を解消する技術サポート・ソリューションを、アクセス・解析システムのデモを通してご提案いたします

### 東芝グループブース案内図



#### ■ 開催日時

2017年5月10日(水)~12日(金)  
10時~18時 (12日のみ17時終了)

#### お問い合わせ先

東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社  
営業技術統括グループ

E-mail : [DME-contact-us@ml.toshiba.co.jp](mailto:DME-contact-us@ml.toshiba.co.jp)

T E L : 044-331-1800